

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2021 年 08 月)

证券简称: 华润微

证券代码: 688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	<u>08 月 19 日 10:00-11:00</u> 广发证券 Ariose Capital Brilliance Capital Management Ltd Marshall Wace Asia Limited Schroders 中邮创业基金 银河基金 盈峰资本 天弘基金 同泰基金 先锋基金 湘财基金 新华基金 兴全基金 沅沛投资 富荣基金 广发基金 国联安基金 国寿安保基金 国投聚力 华夏基金 汇丰晋信基金 吉富创投

	汇丰前海基金 景顺长城基金 麦格理资本 安信基金 百勋资产 北京泓澄投资 北京江亿资本 财通证券资产 淳厚基金 德邦基金 东方阿尔法基金 东吴基金 敦和资产 方正富邦基金 丰和正勤投资 蜂巢基金 海宁拾贝投资 华富基金 建信保险资产 江苏瑞华投资 金元顺安基金 领睿资产 明亚基金 富兰克林华美证券投资信托 宁波灏浚投资 前海开源基金 上海景熙资产 上海聆泽投资 上海明河投资 上海希瓦资产 深圳丰岭资本 深圳市中颖投资 西藏源乘投资 太平资产 玄卜投资（上海） 阳光资产管理 原点资产 浙江思悦投资 浙江英睿投资等 <u>08月19日 15:30-16:30</u> 东方证券
--	--

	浙江韶夏投资
	淡水泉投资
	上银基金
	东方证券资管
	立格资本
	嘉实基金
	浙商基金
	中银基金
	财通基金
	中欧基金
	光大保德信基金
	润晖投资
	海富通基金
	循远资产
	中信保诚基金
	博道基金
	长江证券资管
	中国人寿资产
	德邦资产
	安徽国富产业基金
	翰伦投资顾问
	中海基金
	长见投资
	天合投资
	中融基金
	圆信永丰基金
	泓德基金
	华泰保兴基金
	鹏华基金
	世诚投资
	长盛基金
	兴业基金
	华宝基金
	易方达基金
	东证资管
	民生加银基金
	西部利得基金
	富国基金
	盘京资产
	太平洋资产
	安徽海螺创业投资
	光大资管

	和沅资本管理（北京） 富安达基金 浦银安盛基金 华福基金 诺安基金 瞰道资产 华泰柏瑞基金 创金合信基金 Green Court Capital China Investment 等
时间	08 月 19 日 10:00-11:00、15:30-16:30
地点	华润微电子总部会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	李 虹 华润微电子执行董事、首席执行官 吴国屹 华润微电子董事会秘书兼战略总监
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司对未来行业景气度的看法？ 公司认为今年下半年会延续上半年的行业景气度，对于明年的行情保持谨慎乐观的态度。 问题二：公司未来 5 年的业务长期规划发展？ 公司将保持战略定力，立足现有基础，进一步聚焦于功率半导体、智能传感器和智能控制等广泛应用于新经济领域的半导体产品，通过技术创新保持在业内的领先优势，同时深耕国产替代的中国市场机会，不断推出适应市场需求的新技术、新产品，保持、巩固并提升公司现有的市场地位和竞争优势。 问题三：公司目前接单的情况是否有变化？客户的交期有无变化？ 公司今年接单情况保持稳定，客户目前交期和今年上半年相比没有显著变化。 问题四：公司目前客户的库存水位？ 公司目前客户的库存水位整体仍然处在较低的水平。

	问题五：公司今年下半年是否会进行价格调整？ 公司会密切关注市场变化情况，并采取对应的价格策略。 问题六：请问公司二季度营收环比一季度提升的主要原因？ 公司在今年一季度有安排部分厂房动力检修，今年二季度产能利用率提升，同时公司客户结构和产品结构进一步优化。 问题七：公司新建的 12 吋产线和封测基地，何时可以贡献产能？ 2021 年属于公司 12 吋产线的建设期，预计在 2022 年可以实现产能贡献。 功率半导体封测基地规划分为功率封装与先进封装两大工艺产线，目前计划建设周期为三年。 问题八：公司今年上半年产品结构的改善情况？ 公司聚焦三电领域，今年上半年在电池、电机和电源三大领域的营收较去年同期显著提升，成品化率显著提高，头部客户开拓取得突破。 未来公司将持续增强客户粘度，不断提高产品成品化率，进一步优化产品结构，培育高毛利和有潜力的产品。 问题九：公司车规级业务的进展？ 参照车业项目流程，公司加快 150V 先进中低压 MOS 产品的立项研发，车规级产品体系能力持续完善提升，并积极与国际一流大厂和整车厂对接交流。通过与核心客户深入合作，有序推进产品立项、送样测试及批量供应，在高端应用领域的国产化进程中迈出坚实的步伐。 问题十：车规级产品和普通产品在生产工艺上有无区别？
--	--

	车规级芯片相较于普通芯片,对于稳定性和可靠性有更高要求,产品和工艺都需要一定调整。 问题十一: 公司 IGBT 业务的进展? 未来 IGBT 模块的主要应用领域? 公司 IGBT 产品制造工艺技术全面提升至 8 吋,通过 8 吋 IGBT 技术平台开发和产品系列化研发,进一步提升产品性能与可靠性,通过 IGBT 芯片模块化,进行价值延伸和扩展客户选型空间,2021 年上半年 IGBT 产品销售收入同比增长 94%。 公司 IGBT 模块将主要应用于 UPS、太阳能逆变器、电焊机、变频器等工业控制领域。 问题十二: 公司第三代化合物半导体业务的进展? 公司自主研发的多款 6 吋第一代 650V、1200V SiC JBS 产品实现量产,并实现销售突破;自主研发的第四代 650V SiC JBS 产品实现技术突破,综合性能达到业界先进水平;平面型 1200V SiC MOSFET 产出工程样品,静态技术参数达到国外对标样品水平,正在进行可靠性优化。 自主研发的第一代 650V 硅基氮化镓 Cascode 器件样品静态参数达到国外对标水平,正在进行外延材料质量、芯片面积及工艺的优化,以进一步提升器件可靠性和性价比;自主研发的第一代 650V 硅基氮化镓 E-mode 器件实现器件功能,工艺开发中。 问题十三: 目前市场 MCU 较为紧缺,请简单介绍公司在 MCU 业务的情况? 公司今年上半年 MCU 营收同比增速显著,公司自主研发的采用国产 32 位 CPU IP 的 MCU 产品实现客户导入,并持续开发系列化产品方案。 问题十四: 公司 IPM 模块的主要应用领域和业务
--	--

	进展？ 公司 IPM 模块主要应用于家电和工业控制的变频领域，公司 IPM 模块业务正在有序推进中。 问题十五：未来公司是否会将产能转向自有产品？ 公司新增的产能会更多的向自有产品倾斜。 问题十六：公司成本端是否有价格增长？ 公司目前成本端价格整体保持稳定。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 08 月